

# Investor Relations



PSK GROUP

Mar. 2026

# Disclaimer

---

여기에 포함된 2025년 말 PSK 그룹("회사")의 경영 성과 및 재무 결과에 관한 모든 정보는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

여기에 포함된 정보는 투자자의 투자 결과와 관련하여 어떠한 법적 목적에도 활용되어서는 안 됩니다. 이에 따라 회사는 여기에 포함된 정보에 대한 투자자의 의존으로 인해 발생하는 손실 또는 손해에 대한 일체의 책임을 명시적으로 부인합니다.

이 자료의 일부 정보와 데이터는 가정과 미래지향적 진술에 기초하여 작성되었습니다. 이러한 미래지향적 가정과 진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하며 변경될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

# Contents

---

## 01 회사소개

PSK 그룹	05
연혁	06
네트워크	07
주요 고객사	09
경쟁력	10

## 02 사업소개

PSK	12
PSK 홀딩스	16

## 03 투자

연구활동	19
CapEx	20

## 04 ESG

ESG 경영	22
환경	23
사회	24
지배구조	26
고객사 평가	27

## 05 성과

재무정보	29
주가정보	31

# 회사소개



---

PSK 그룹	05
연혁	06
네트워크	07
주요 고객사	09
경쟁력	10

01



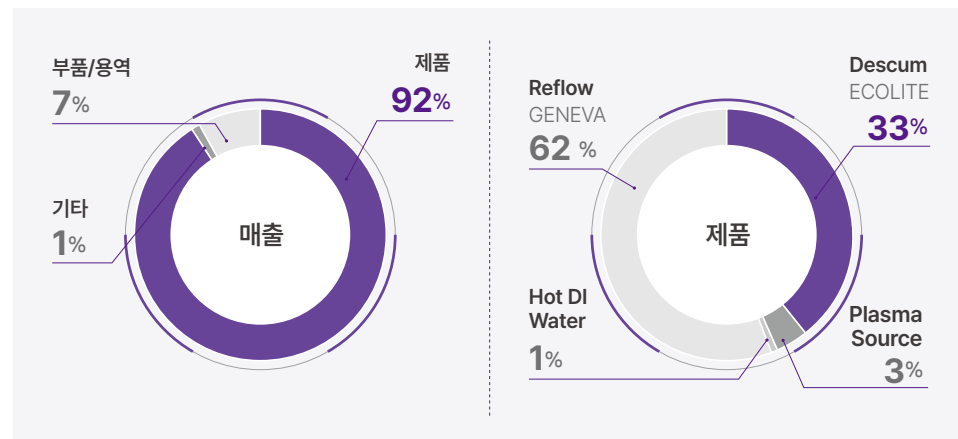
PSK 홀딩스

회사명	피에스케이홀딩스 주식회사
설립일	1990.06
자본금	107.8억
대표이사	박경수
주요사업	반도체 장비(292908)
임직원	112명
주소	경기도 화성시 삼경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449
CEO 약력	PSK 그룹 회장 1990 ~ 현재 PSK 홀딩스 대표이사 1990 ~ 현재 PSK 회장 2019 ~ 현재 코스닥 상장법인 협의회 회장 2007 ~ 2009

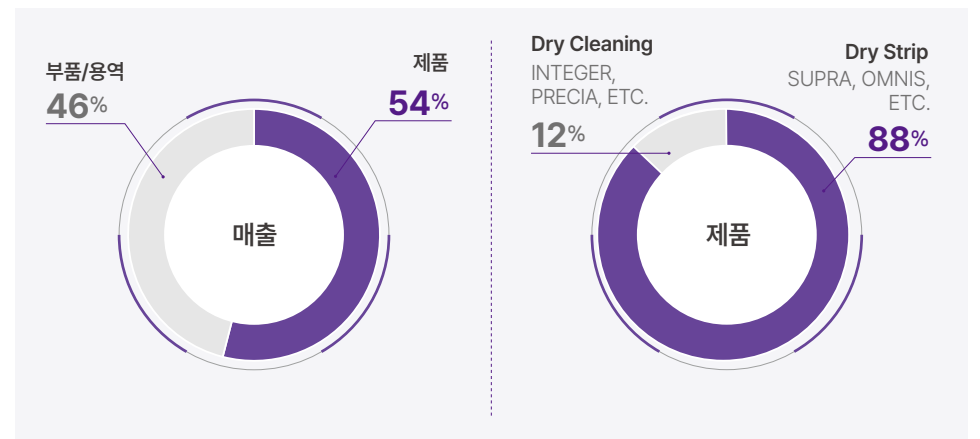
PSK

회사명	피에스케이 주식회사	
설립일	2019.04	
자본금	146.2억	
대표이사	이경일, 하형찬 (각자 대표이사)	
주요사업	반도체 장비(292908)	
임직원	330명	
주소	경기도 화성시 삼성1로4길 48 우편번호 18449	
CEO 약력	PSK 대표이사 2019 ~ 현재 PSK 2016 ~ 현재 Mattson Technology 2004 ~ 2015 Applied Materials 1996 ~ 2003	PSK 대표이사 2026 ~ 현재 PSK 2019 ~ 현재 Applied Materials 2000 ~2010 Hynix 1990 ~ 1994

2025년말 기준



2025년말 기준

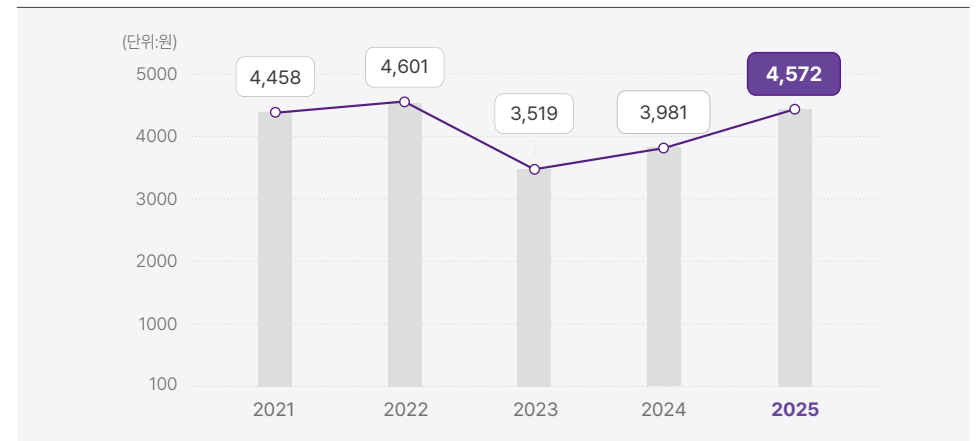




PSK Holdings 매출액 (연결)



PSK 매출액 (연결)





**PSK 홀딩스**

소재지  
대한민국 화성시

- 3D Package 장비 사업
- Fluxless Reflow 장비
- Descum 장비

▼ 32.76%

**PSK**

소재지  
대한민국 화성시

- 웨이퍼 제조 장비사업
- Dry Strip 장비
- Dry Cleaning 장비
- Plasma Wafer Edge Cleaning 장비

▶ **SEMIgear** Fluxless Reflow 기술 원천

▶ **PSK Asia** 현지 영업 및 현장 서비스업

▶ **PSK China** 현지 영업 및 현장 서비스업

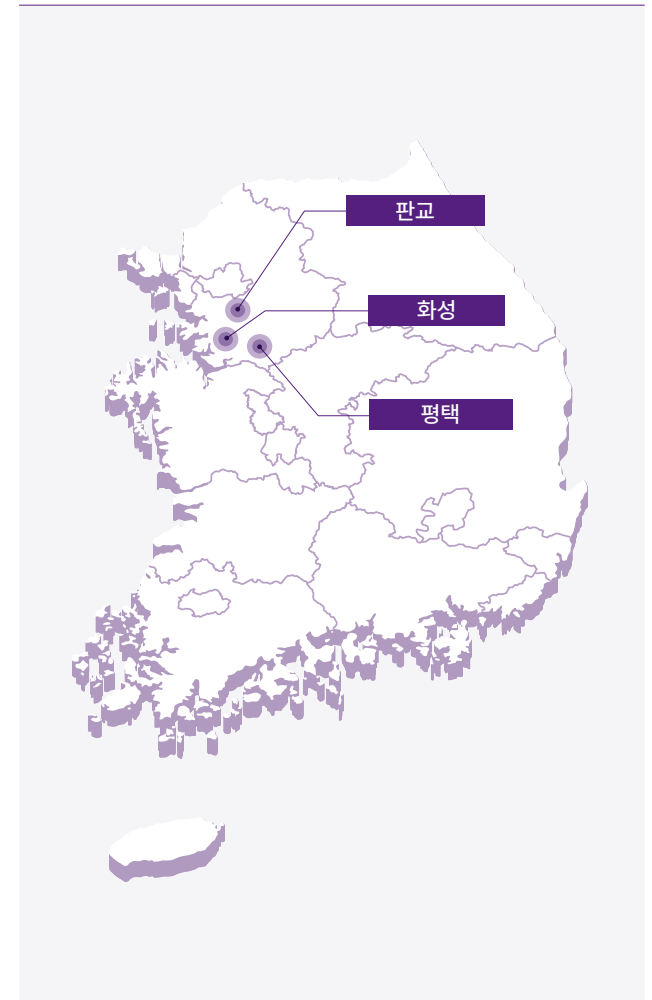
▶ **PSK Shanghai** 부품 사업

▶ **PSK America** 현지 영업 및 현장 서비스업

▶ **PSK Japan** 현지 영업 및 현장 서비스업

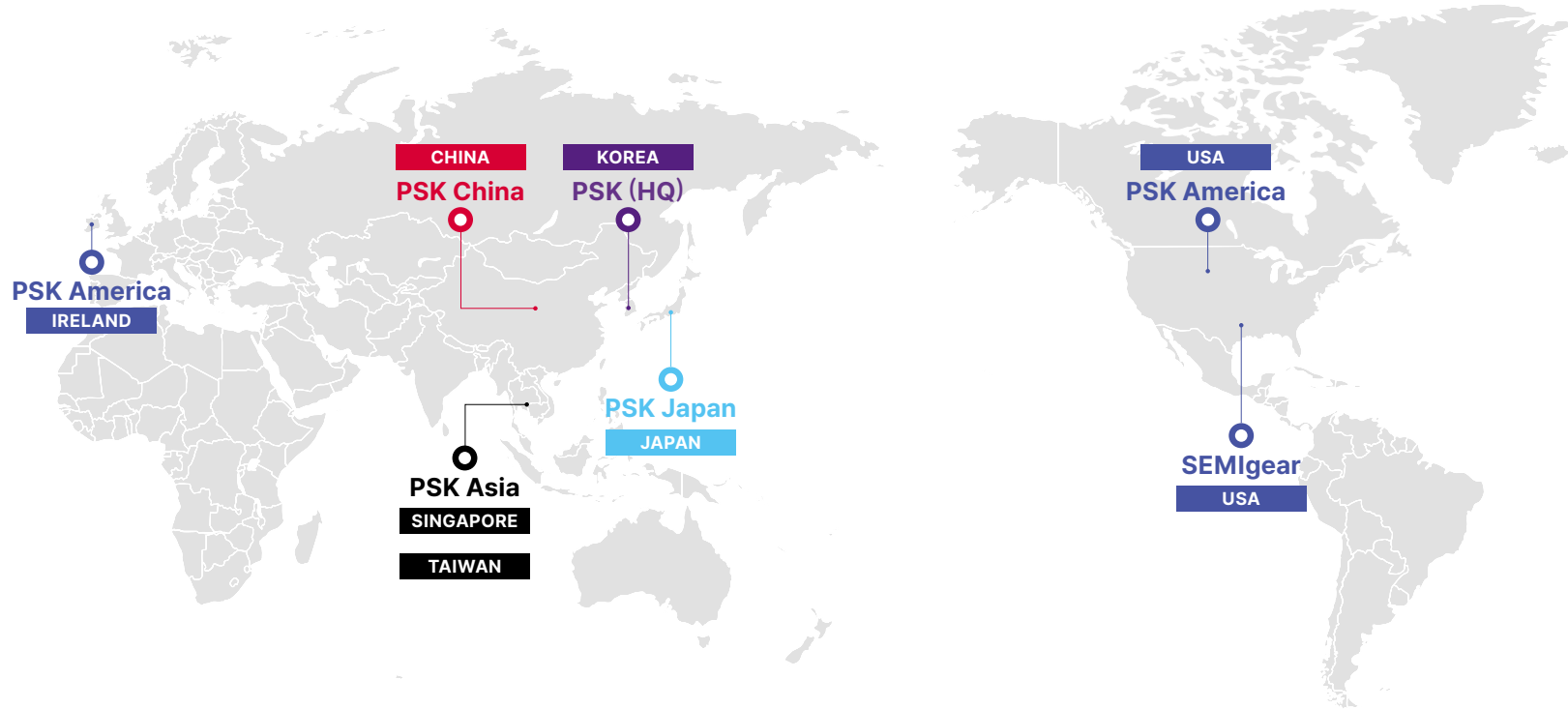
▶ **SE&S / SE&T / SE&I** 현장서비스업 / 부품조립업

대한민국





7 국가  
25 거점



**PSK (HQ)**

- 화성
- 평택
- 판교

**PSK Asia**

- 신주
- 린커우
- 타이중
- 타이난
- 싱가포르

**PSK China**

- 시안
- 허페이
- 청두
- 우한
- 샤먼
- 취안저우
- 우시
- 다렌
- 상하이
- 베이징

**PSK Japan**

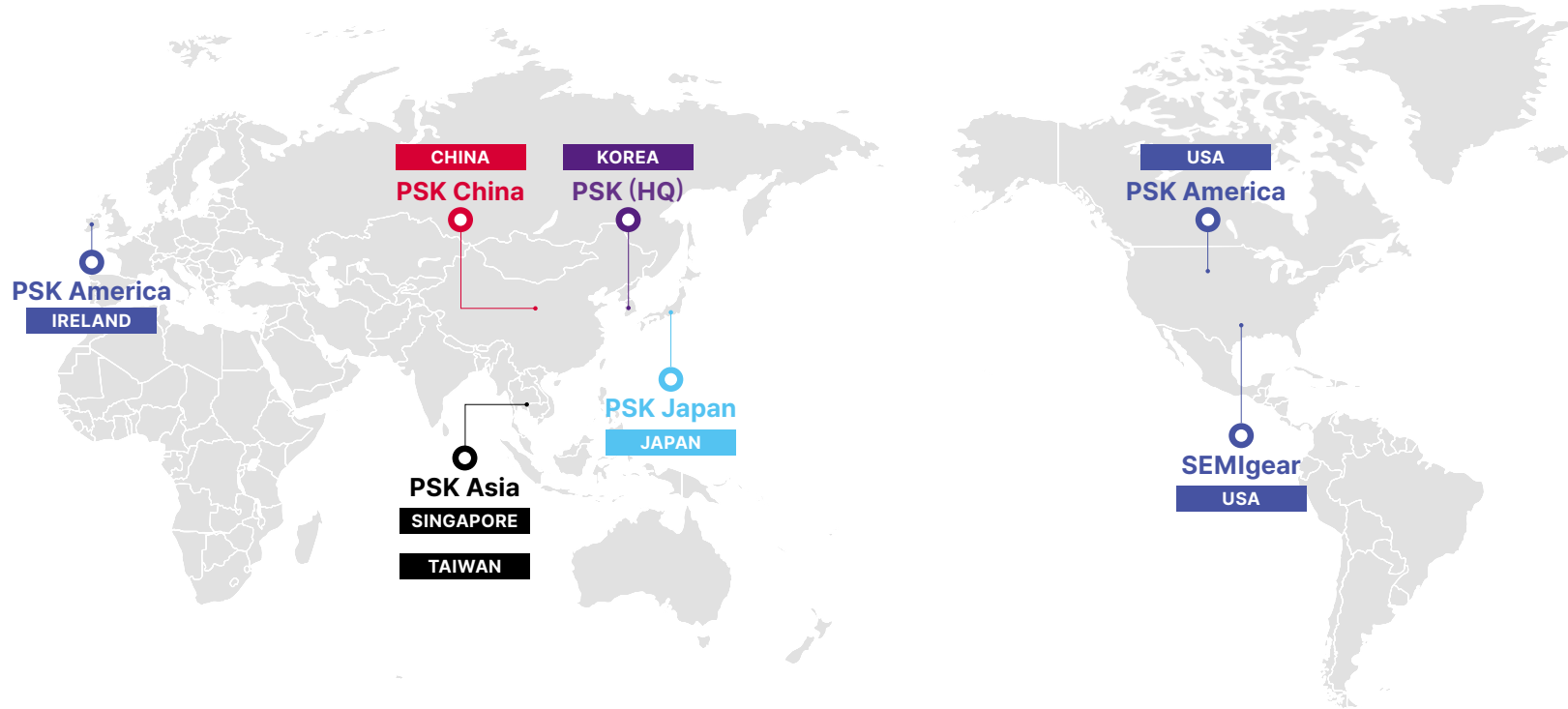
- 히로시마

**PSK America**

- 힐즈버러
- 보이시
- 캔들러
- 오스틴
- 더블린

**SEMIgear**

- 오스틴



**Korea**

SAMSUNG, SK hynix, ne:es

LB Semicon, DB HiTek, SFA SEMICON

Amkor technology, STATSchipPAC, Dow

**China**

YATC, SAMSUNG, JHIC 晋华, SK hynix, CHIPMORÉ

i!N INNOTRON, JSX, GLOBAL P&B DRORIES, jaup 江苏华通电子通信技术有限公司, GCJET

华天科技, 通富微电, SJSEMI, CXMT, SMEC, EIT

**Asia**

UMC, winbond, CHIPROND, Winstek, Micron, hp

NANUK, MITI, Amkor Technology, GREATECH, GLOBAL P&B DRORIES, TATSchipPAC, ne:es

SPL, Powertech Technology Inc., tsmc, RAYTEK Raytek Semiconductor, Inc., in FLASH SINGAPORE, sunsem, U-TAC

**USA**

Micron, SAMSUNG

intel, GLOBAL P&B DRORIES

IBM, Texas Instruments

**Europe** intel, GLOBAL P&B DRORIES

**Japan** Micron, FE, FUJITSU, SONY, MITSUBISHI ELECTRIC, BOSOL, KIOXIA



**기술력**  
Dry Strip 분야의 전세계 1위 기술 기업  
높은 기술력을 활용한  
세계시장 40% 이상 점유



**고객사**  
주요 고객과의 강력한 파트너십  
일류 고객들과 초미세 공정기술  
및 장비 공동개발



**PSK  
그룹**

**재무건전성**  
지속가능한 성장과 재무구조  
낮은 부채비율과 건전한 재무구조 확립



**시스템 (TTTM)**  
Tool to Tool Matching  
생산되는 장비가 동일한 성능을 낼 수 있도록  
TTTM시스템을 구축하여 관리의 표준화 및 고도화



**협력사**

협력업체와 좋은 관계유지  
부품 공동개발 확대를 통한 국내 산업기반 강화

# 사업소개



---

PSK	
Dry Strip	12
Dry Cleaning	13
New Hard Mask Strip	14
Bevel Etch	15

---

PSK 홀딩스	
Descum	16
Reflow	17



8대 공정

웨이퍼

산화

포토 리소그래피

식각 [Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

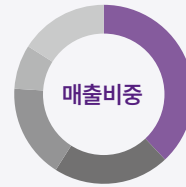
패키징

세계 최고 점유율 기반의 드라이 스트립 장비

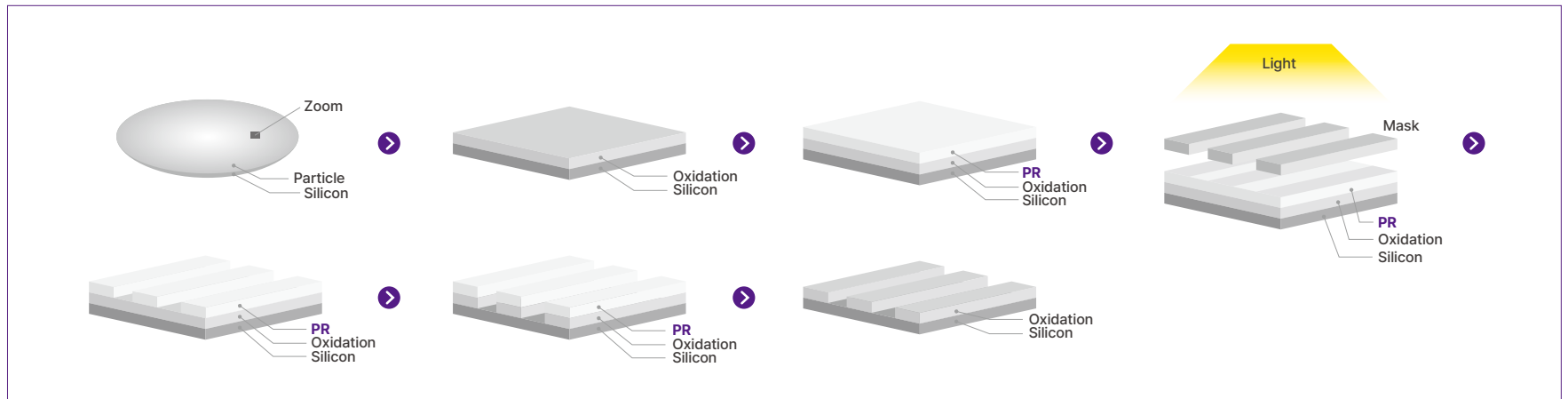
SUPRA는 안정적인 드라이 스트립 공정을 지원하며, 최소 면적 설계로 높은 처리량과 낮은 CoO를 구현합니다. ICP, CCP, MW 등 다양한 플라즈마 기술과 화학을 지원합니다. 또한 Bulk Strip뿐만 아니라 HDIS, Metal, Low-K 등 첨단 공정에도 적용할 수 있습니다.

특징

- High productivity
- High strip rate
- High reliability and low CoO



- 한국 38%
- 미국 21%
- 대만 17%
- 중국 8%
- 기타 16%





8대 공정

웨이퍼

산화

포토 리소그래피

식각 [Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

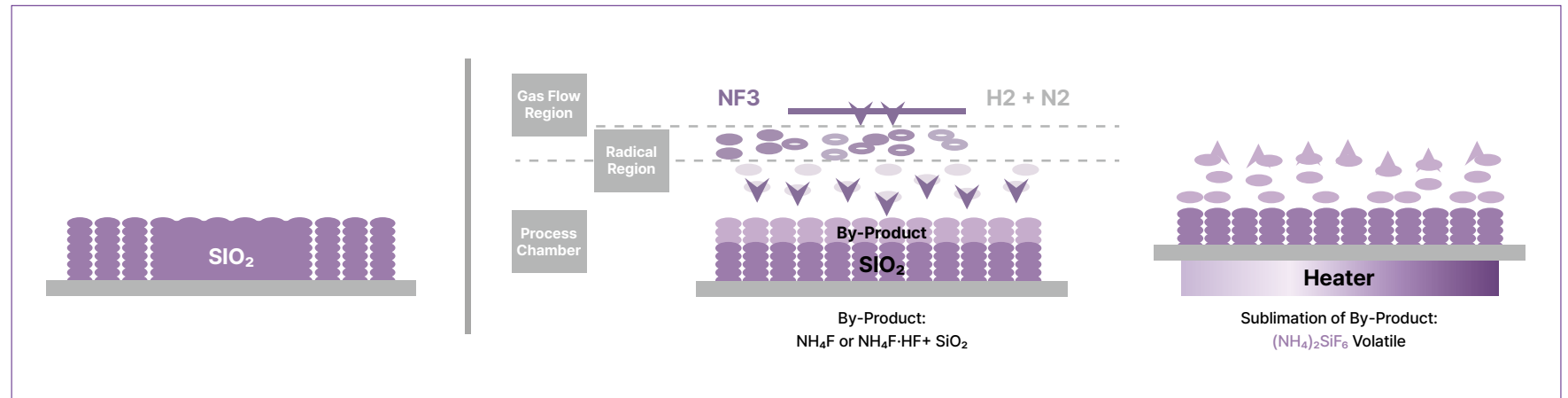
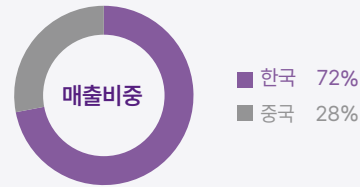
패키징

표면 및 Plasma Oxide Cleaning 선도 장비

INTEGER는 웨이퍼 표면의 자연 산화막과 불순물을 제거하여 무결점 인터페이스를 구현합니다. 소자 미세화에 따라 인터페이스 세정의 중요성이 증가하고 있습니다. INTEGER는 우수한 계면 처리 공정을 제공하여 소자 특성을 확보합니다. Chuck · Baffle 온도 및 화학 최적화를 통해 높은 선택비와 등방성 식각을 달성합니다. 또한 높은 균일성과 생산성을 확보하고 낮은 CoO를 보장합니다.

특징

- Plasma-enhanced cleaning system for removal of oxides, nitrides, and poly-Si
- Excellent cleaning capability for various AR contact patterns
- In-Situ damaged Si removal with high selectivity for SiN
- Excellent controllability for cleaning process





8대 공정

웨이퍼

산화

포토 리소그래피

식각 [Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

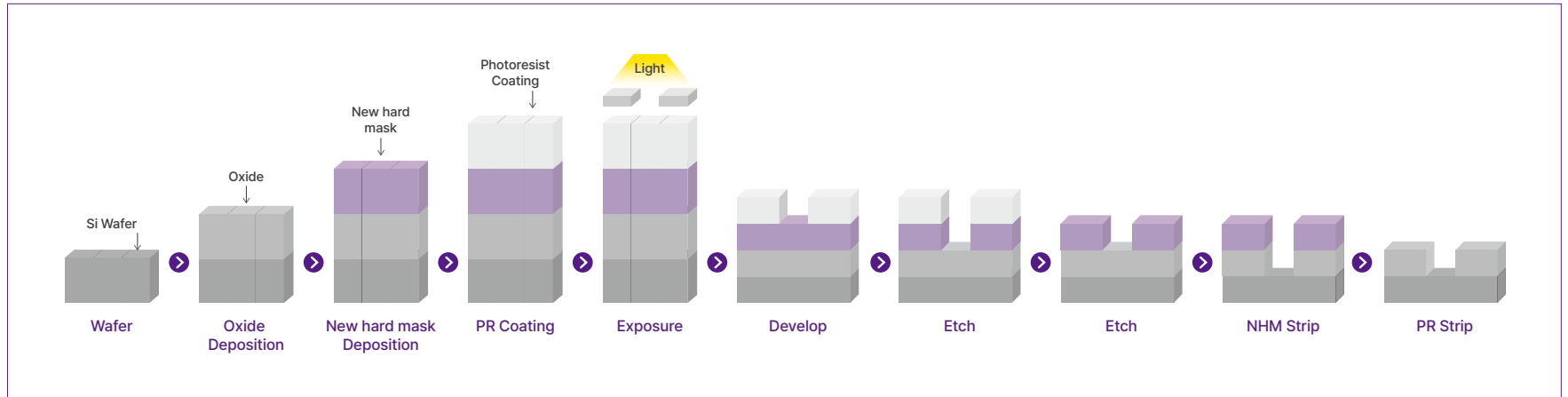
패키징

첨단 노드 하드마스크 제거 플랫폼

소자 미세화로 Aspect Ratio가 증가하면서 높은 내식성 하드마스크가 필요해지고 있습니다. 그러나 기존 제거 방식으로는 이러한 필름을 제거하기 어렵습니다. OMNIS는 높은 선택비로 하드마스크를 제거하면서 기판(Oxide, Nitride 등)의 손상을 최소화합니다.

특징

- Unique product for doped hard mask removal
- Extreme selectivity for dielectric films
- Excellent hard mask strip performance without pattern damage
- Si oxidation controllability





8대 공정

웨이퍼

산화

포토 리소그래피

식각 [Asher]

박막 증착

금속 배선

EDS

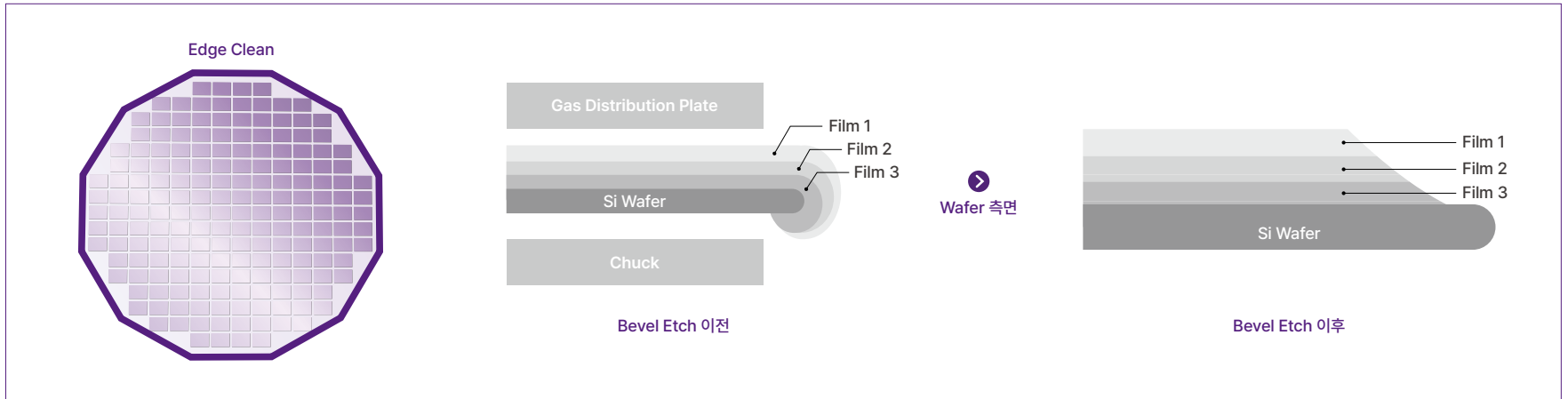
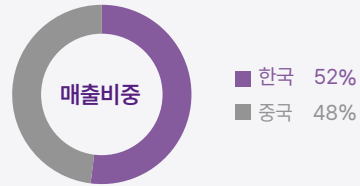
패키징

차세대 공정을 위한 고신뢰성 베벨 에칭 솔루션

PRECIA는 웨이퍼 에지 필름을 제거하여 수율을 향상시키고, 불필요한 에지 필름을 제거해 파티클 및 표면 손상을 방지합니다. 또한 Auto Wafer Centering 및 비전 얼라인먼트를 통해 균일한 에칭과 안정성을 제공하며, 낮은 CoO를 실현합니다.

특징

- High productivity & low CoO
- Dual plasma source
- High wafer transfer performance by precise auto wafer centering
- Wafer bevel etch monitoring with vision system





8대 공정

- 웨이퍼
- 산화
- 포토 리소그래피
- 식각
- 박막 증착
- 금속 배선
- EDS

- 패키징 [Advanced Package]

Descum 및 표면처리 분야 세계 최고의 솔루션 제공

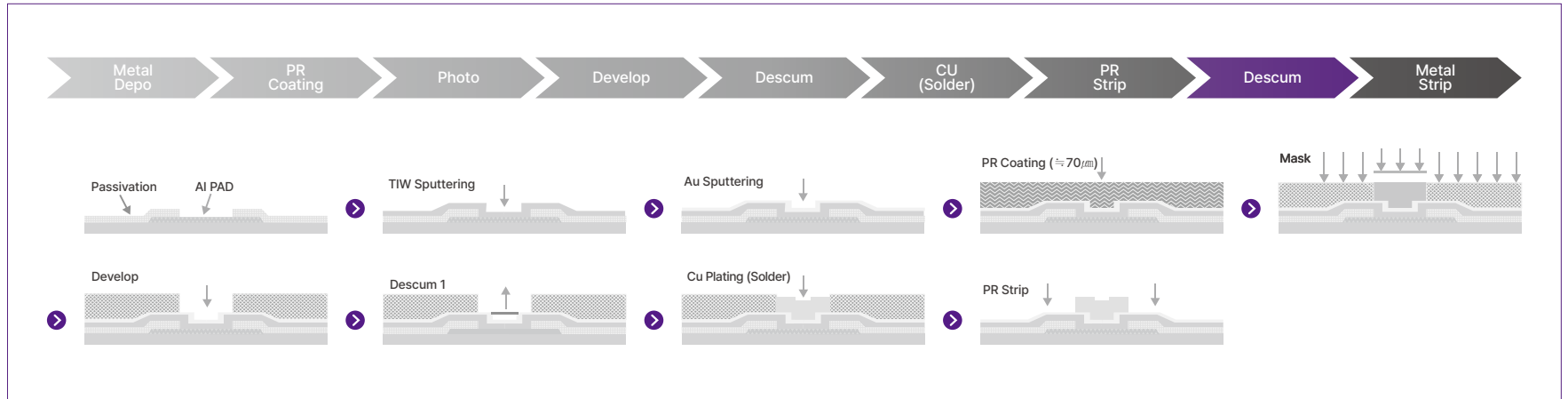
ECOLITE 시리즈는 Wafer-Level 및 Panel-Level 반도체 패키징 생산에서 다양한 Descum 및 표면처리 공정을 지원합니다. Descum은 리소그래피 후 잔류 찌꺼기를 제거하는 공정으로, RDL Profile과 Bump 형성에 중요한 역할을 합니다. 표면처리는 필름 코팅 전·후 잔류물 및 금속 이온을 제거하고, 표면 거칠기와 친수성을 개선하여 접착력을 향상시킵니다.

**특징**

- High productivity
- High reliability & low CoO
- Single & Dual plasma source
- Small footprint

**매출비중**

한국	16%
대만	43%
중국	35%
기타	5%





8대 공정

웨이퍼

산화

포토  
리소그래피

식각

박막 증착

금속 배선

EDS

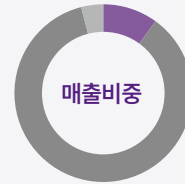
패키징  
Advanced Package

### Fluxless Bump Reflow 분야 세계적 경쟁력

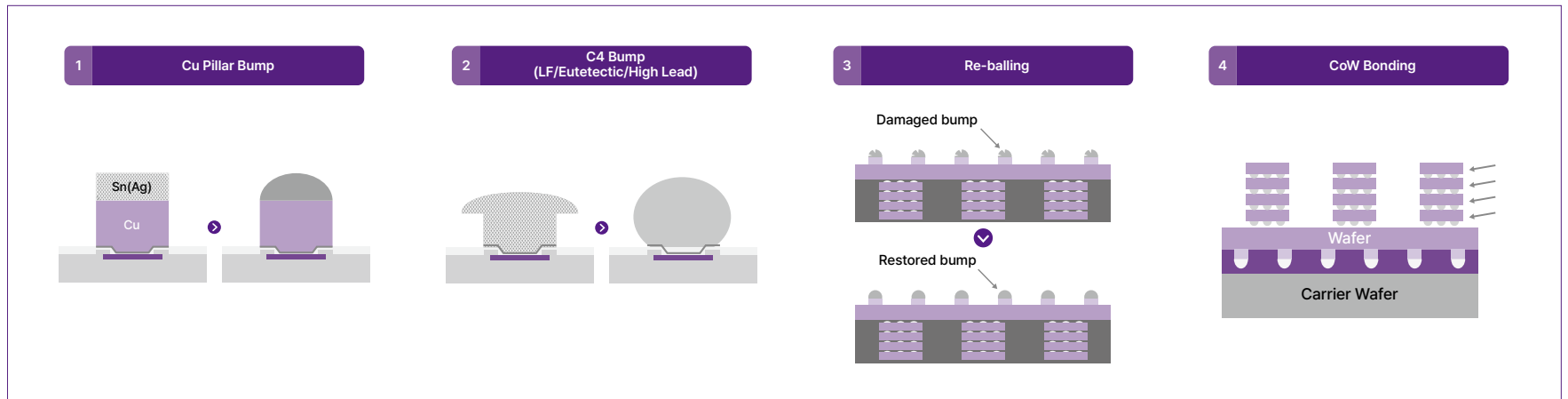
Fluxless Bump Reflow 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. GENEVA는 세계 최초로 Fluxless Reflow 양산에 성공하여 검증된 안정성과 품질을 제공합니다. 또한 Plating Bump Reflow 및 Bonding 응용을 지원하며, 글로벌 고객과 협업합니다. 더불어 HBM, 2.5D와 같은 고사양 패키징 솔루션도 제공합니다.

특징

- Low CoO & high reliability
- Small footprint
- Warpage minimization
- High productivity
- High throughput & yield



■ 한국	10%
■ 대만	86%
■ 중국	4%



# 투자



---

연구활동

19

CapEx

20

03



## PSK 홀딩스

(단위: 백만원, %)

연도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
연구비	7,296	7,514	9,682	12,081	13,321
매출액	81,624	72,791	94,716	215,508	207,764
인원	94	91	91	112	130
연구원	34	33	34	41	49
연구인원 비율	36.2	36.3	37.2	36.6	37.8

\* 연결 기준

## PSK

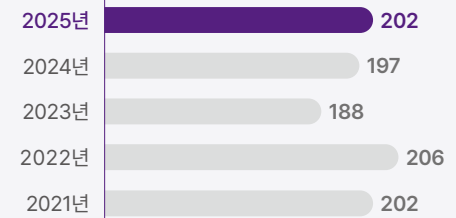
(단위: 백만원, %)

연도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
연구비	24,153	28,755	27,720	34,439	35,728
매출액	445,804	460,909	351,863	398,051	457,213
인원	330	343	334	330	329
연구원	120	122	122	127	129
연구인원 비율	36.4	35.6	36.5	38.5	39.2

\* 연결 기준

(단위: 건)

## 특허권



(단위: 건)

## 특허권





PSK 판교 캠퍼스



용인 반도체클러스터 일반산업단지



위치	경기도 성남시 수정구 금토동 일원 (판교 제2테크노벨리)
규모	대지면적 4,544 제곱미터 연면적 41,627 제곱미터 (약 12,592평)
투자금액	825억원
준공	2024년 5월

위치	경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리, 고당리, 죽능리 일원 (SK 하이닉스 인근 부지)
규모	대지면적 15,412 제곱미터 (약 4,662평) 용적률 350% 이하
투자금액	N/A
준공	2028년 예정

# ESG



---

ESG 경영	22
환경	23
사회	24
지배구조	26
고객사 평가	27



CEO Message

지속가능한 미래를 창조하는 ESG 경영의 모범기업이 되겠습니다.

존경하는 이해관계자 여러분, 안녕하십니까?

지난 30여년간 PSK그룹에 변함없는 관심과 지지를 보내주시는 주주, 고객, 협력사, 그리고 임직원 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2019년부터 발생한 COVID-19 팬데믹 지속과 글로벌 공급망 이슈 등 쉽지 않은 경영환경이 지속되고 있으며 기후변화, 환경오염, 인플레이션 등 수 많은 환경적, 사회적 문제로 인해 “지속 가능한 미래”를 구축하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

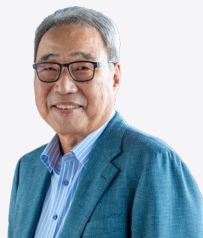
이러한 시대 변화에 한 발 앞서 대응하기 위해 PSK그룹은 지속 가능성을 경영의 최고 가치로 삼고 회사의 각 조직에 적용하고자 합니다.

PSK그룹은 지속가능한 경영 체제를 구축하기 위해 ISO 14001 인증을 통한 환경경영시스템을 구축하였으며 자원의 효율적인 사용 및 에너지 절감, 그린(Green) 빌딩 구축 등 친환경 활동을 강화하고 있습니다. 그리고 기업의 사회적 책임을 다하고자 다양한 기부 및 봉사활동을 수행하고 있으며, 노동인권 및 안전 보건 분야에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 이사회 중심 경영 및 전자투표제 도입 등을 통해 지배구조 선진화를 위해 노력하고 있습니다.

PSK그룹은 “종합 프로세스 장비의 글로벌 리더”라는 비전에 ESG의 가치를 더해 회사가 지속가능한 성장을 만들어 내는 데 더욱 집중하겠습니다. 감사합니다.

피에스케이홀딩스 주식회사  
대표이사 박경수

박경수



피에스케이 주식회사  
대표이사 이경일

이경일



ESG 위원회





# ISO 인증, 안전보건 및 중대재해 대응



## 안전보건

1. 안전보건목표	▶ 매년 안전보건목표 수립 및 연 2회 모니터링, 준수평가 실시
2. 유해위험기계기구	▶ 자체 정기검사 실시
3. 비상사태	▶ 잠재적 비상 사태 및 위험성 식별 및 평가, 대응 프로그램 수립, 비즈니스연속성계획(BCP), 정기훈련, ERT 교육
4. 임직원 안전보건	▶ 정기 교육, 정기 건강검진, 건강관리프로그램 운영

## 중대재해 대응

1. 예방	▶ 고위험 작업 및 유해위험요인 식별, 작업 장소에 비상경광등 및 비상연락망 설치
2. 중대재해 대응 프로세스 구축	▶ 위험요인별 맞춤 시나리오 구축, 연 2회 대응훈련 실시
3. 비상대책위원회	▶ 중대재해 발생시 긴급 비상대책위원회 및 산업안전보건위원회 소집
4. 재발 방지 대책 수립	▶ 재발 방지 대책 이행계획서, 작업 프로세스 개정
5. 모니터링 및 교육	▶ 지속적인 모니터링 및 안전교육 실시



[ISO 45001 인증서]



협력사 관리

매년 PQCA(PSK Quality Certification Awards)를 통하여 우수 BP(Business Partner)사를 선정하여 시상 및 협력사 관리 활동 시행

2025년 PQCA

일시	2026년 2월 5일 PSK 판교캠퍼스
참가	PSK Group Key Partner
내용	2025년 구매, 품질, 보안, 전략 공유 및 우수 BP사 수상
우수업체 선정 기준	PSK SQP(Supplier Quality Platform)에 근거하여 Key Partner의 품질, 납기, 협조도 3부문 지표를 측정



2025년 사회공헌활동

PSK 그룹 봉사단 '봉우리'는 노인, 아동, 장애인 등 사회의 취약계층에 다양한 사회 공헌 활동을 수행

3월 29일  
궁평항 비치코밍



7월 26일  
주거 환경 개선



9월 16일  
추석 나눔



9월 23일  
이웃사랑 바자회



11월 22일  
김장 나눔



12월 16일  
무료 급식소





## PSK 홀딩스

이사회	<b>박경수   의장·대표이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>고려대 경영학 학사</li> <li>미국 캘리포니아주립대(원) MBA</li> <li>피에스케이(주) 이사회 의장</li> </ul>	<b>박진경   사내이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KAIST 산업디자인 학사</li> <li>NHN 근무</li> <li>XLGAMES 근무</li> </ul>	<b>박연경   사내이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>서울대(원) 경영학 석사</li> <li>삼성전자(주) 근무</li> <li>롯데홈쇼핑 근무</li> </ul>	<b>강사운   사외이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>삼성전자(주) PKG개발팀 팀장</li> <li>삼성전기(주) PLP사업팀 팀장</li> <li>한국마이크로 전자 및 패키징 학회장</li> </ul>	<b>정진욱   사외이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KAIST 물리학과 박사</li> <li>한양대학교 전기공학과 교수</li> <li>반도체디스플레이 기술학회 플라즈마 RF 연구회장</li> </ul>

## PSK

이사회	<b>박경수   의장</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>고려대 경영학 학사</li> <li>미국 캘리포니아주립대(원) MBA</li> <li>피에스케이홀딩스(주) 이사회 의장</li> </ul>	<b>이경일   대표이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KAIST(원) 재료공학석사</li> <li>서울대(원) 재료공학박사</li> <li>Applied Materials 근무</li> </ul>	<b>하형찬   대표이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehigh Univ Materials Science(원) 박사</li> <li>SK Hynix 근무</li> <li>Applied Materials 근무</li> </ul>	<b>김동진   사내이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Columbia Business School MBA</li> <li>삼성전자(주) 근무</li> <li>휴렛패커드 근무</li> </ul>	<b>강필성   사외이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>서울대(원) 산업공학과 박사</li> <li>서울대학교 산업공학과 부교수</li> <li>LG CNS 제조 AI 자문교수</li> </ul>
	<b>정우인   사외이사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KAIST(원) 재료공학과 박사</li> <li>연세대학교 연구교수</li> <li>Lam Research Korea 근무</li> </ul>				



# 성과



---

재무정보	29
주가정보	31



## 2025년 4분기 실적

(단위: 십억 원)

	25년 4분기	25년 3분기	전분기 대비 증감	24년 4분기	전년 대비 증감
매출액	51.4	90.6	-76.3%	97.8	-47.4%
매출총이익	32.3	57.3	-77.4%	65.9	-51.0%
판매관리비	18.1	16.1	11.0%	22.8	-20.6%
영업이익	14.2	41.2	-190.1%	43.2	-67.1%

\*작성기준: 연결재무제표

## 요약재무제표

재무상태표

(단위: 십억 원)

	2023년		2024년		2025년	
자산	401.4	100.0%	513.6	100.0%	584.9	100.0%
유동자산	165.2	41.2%	241.1	46.9%	268.8	46.0%
부채	60.1	15.0%	82.1	16.0%	78.5	13.4%
유동부채	35.1	58.4%	51.7	63.0%	48.4	61.7%
자본	341.3	85.0%	431.5	84.0%	506.4	86.6%
자본금	10.8	3.2%	10.8	2.5%	10.8	2.1%
부채자본비율	17.6%		19.0%		15.5%	

\*작성기준: 연결재무제표

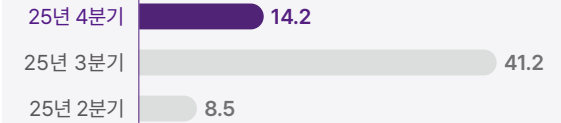
손익계산서

(단위: 십억 원)

	2023년	2024년	2025년
매출액	94.7	215.5	207.8
매출총이익	57.9	135.8	130.6
영업이익	27.0	88.5	73.4
당기순이익	42.7	95.8	91.7
영업이익률	28.5	41.1	35.3

\*작성기준: 연결재무제표

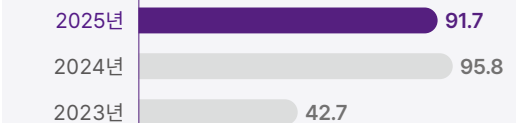
## 영업이익



## 자산



## 당기순이익





## 2025년 4분기 실적

(단위: 십억 원)

	25년 4분기	25년 3분기	전분기 대비 증감	24년 4분기	전년 대비 증감
매출액	142.7	104.1	27.0%	105.3	35.5%
매출총이익	69.1	52.0	24.7%	53.1	30.1%
판매관리비	47.2	28.6	39.4%	42.6	10.8%
영업이익	21.9	23.4	-6.8%	10.8	102.8%

\*작성기준: 연결재무제표

## 요약재무제표

재무상태표

(단위: 십억 원)

	2023년		2024년		2025년	
자산	494.4	100.0%	569.4	100.0%	656.0	100.0%
유동자산	353.6	71.5%	398.6	70.0%	442.8	67.5%
부채	101.8	20.6%	97.6	17.1%	107.0	16.3%
유동부채	86.1	84.6%	81.2	83.2%	89.4	83.6%
자본	392.5	79.4%	471.7	82.8%	539.0	82.2%
자본금	14.6	3.7%	14.6	3.1%	14.6	2.7%
부채자본비율	25.9%		20.7%		19.9%	

\*작성기준: 연결재무제표

손익계산서

(단위: 십억 원)

	2023년	2024년	2025년
매출액	351.9	398.1	457.2
매출총이익	164.6	209.6	223.2
영업이익	54.1	84.0	88.5
당기순이익	52.5	79.1	78.5
영업이익률	15.4	21.1	19.4

\*작성기준: 연결재무제표

## 영업이익



## 자산



## 당기순이익





PSK 홀딩스

(통화: 원, 1주)

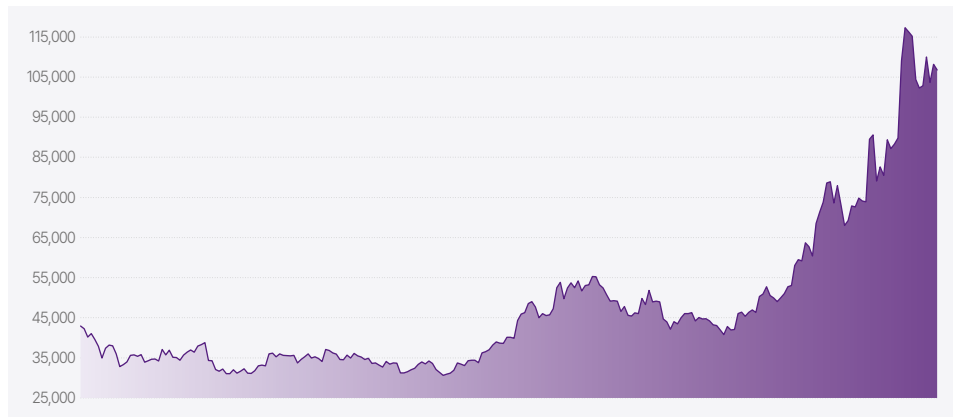
	2023	2024	2025
배당금	600	700	1,080

\*작성기준: 연결재무제표

	2023	2024	2025
배당성향	30.3%	15.8%	25.4%

\*작성기준: 연결재무제표

	2023	2024	2025
EPS (₩)	1,980	4,444	4,252
BPS (₩)	15,829	20,010	23,484
PER (x)	13.6	8.6	10.9
PBR (x)	1.7	1.9	2
ROE (%)	13.7	24.8	19.6
ROA (%)	11.7	20.9	16.7



PSK

(통화: 원, 1주)

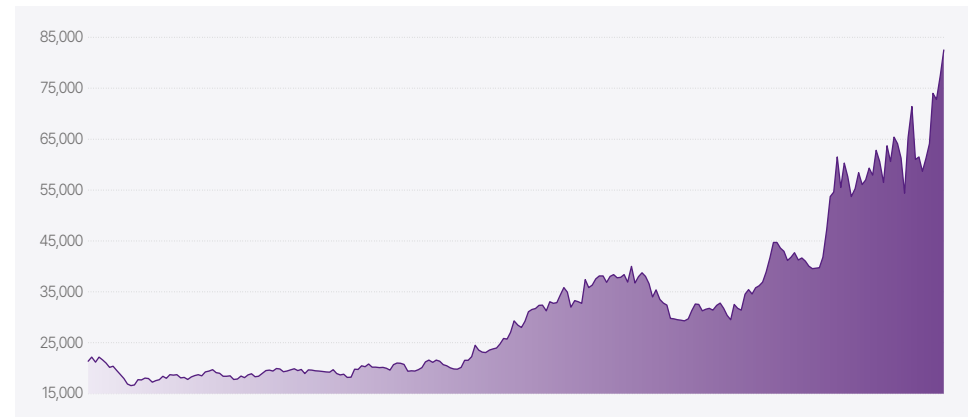
	2023	2024	2025
배당금	200	400	680

\*작성기준: 연결재무제표

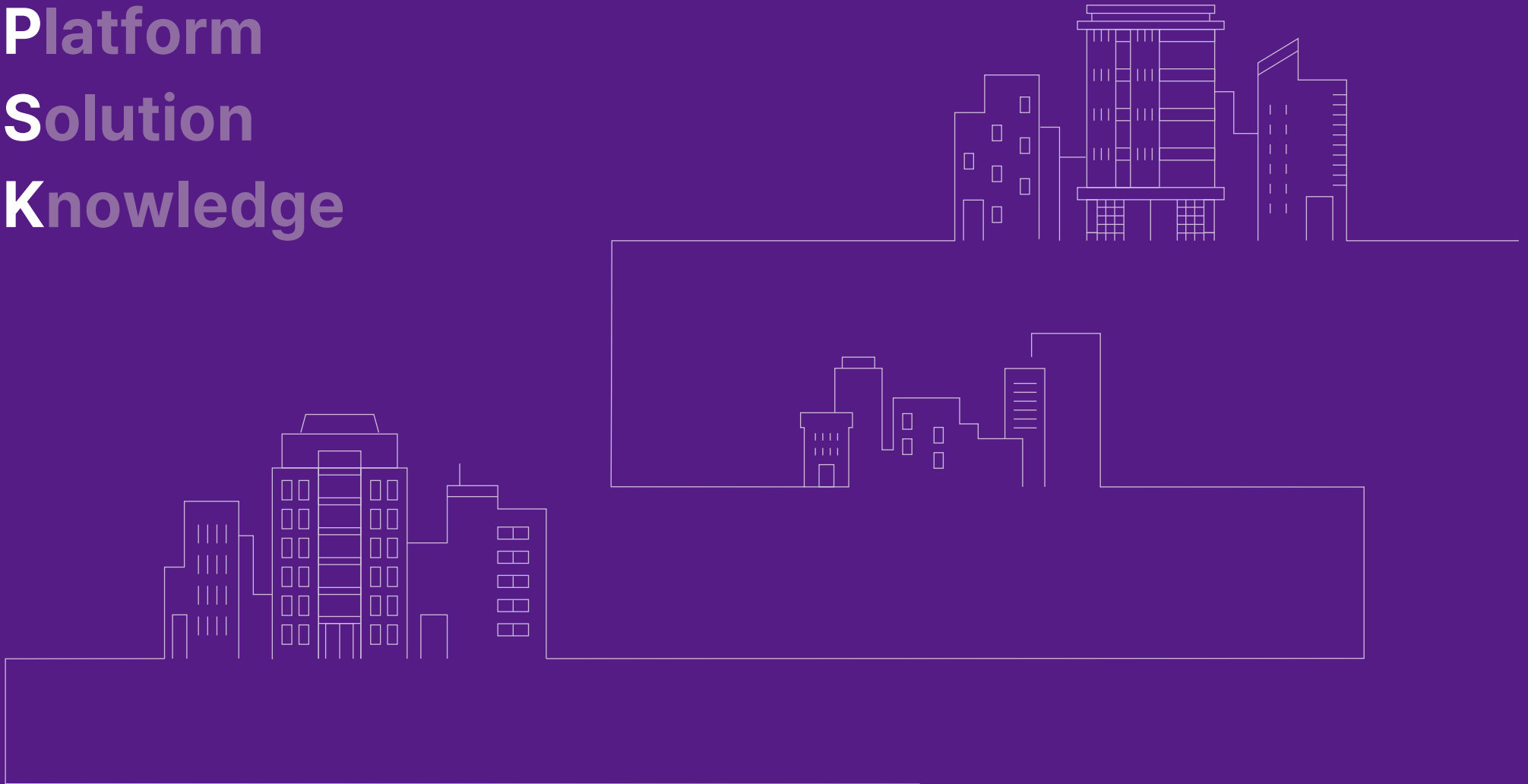
	2023	2024	2025
배당성향	11.0%	14.6%	25.1%

\*작성기준: 연결재무제표

	2023	2024	2025
EPS (₩)	1,813	2,732	2,712
BPS (₩)	13,552	16,285	18,606
PER (x)	11.6	6.0	13.6
PBR (x)	1.6	1.0	2.0
ROE (%)	14.1	18.3	15.5
ROA (%)	10.9	14.9	12.9



# Platform Solution Knowledge



## PSK GROUP

경기도 성남시 수정구 금토로 75 (13453)

031)660-8799 | [www.pskholding.com](http://www.pskholding.com) | [www.pskinc.com](http://www.pskinc.com)